

2019年3月期 第2四半期 決算説明会

2018年11月16日



内外テック株式会社
JASDAQ3374

2019年3月期 第2四半期実績

代表取締役社長 岩井田 克郎

所在地	東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結555名（2018年9月末）
連結子会社	内外エレクトロニクス(株) 納宜伽義機材（上海）商貿有限公司

内外テック 営業所・物流センター・開発センター
内外エレクトロニクス 事業所・サービスセンター

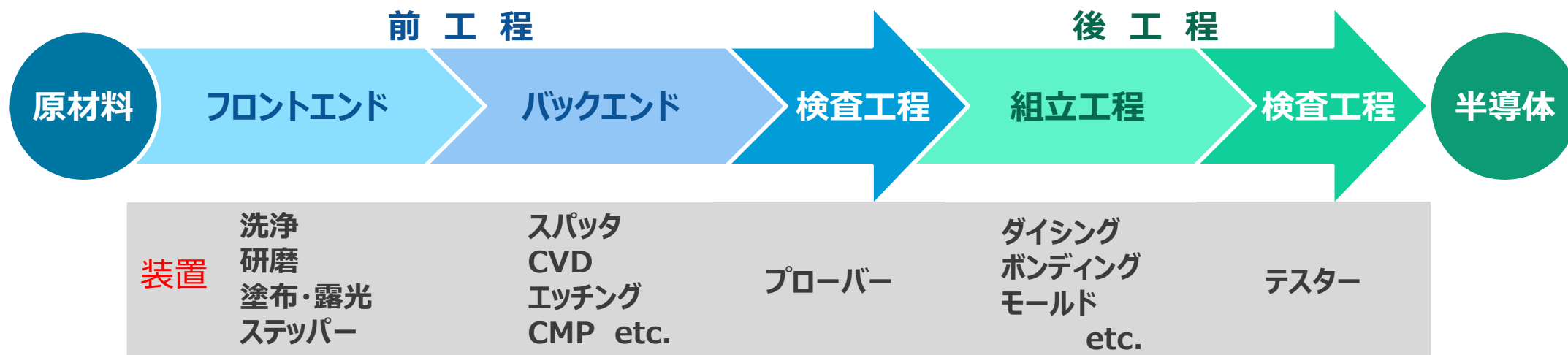
中国・上海



納宜伽義機材
(上海)



半導体製造工程概要



-当社の得意分野-
3D NANDメモリ需要増により
特にエッチング装置の需要が牽引



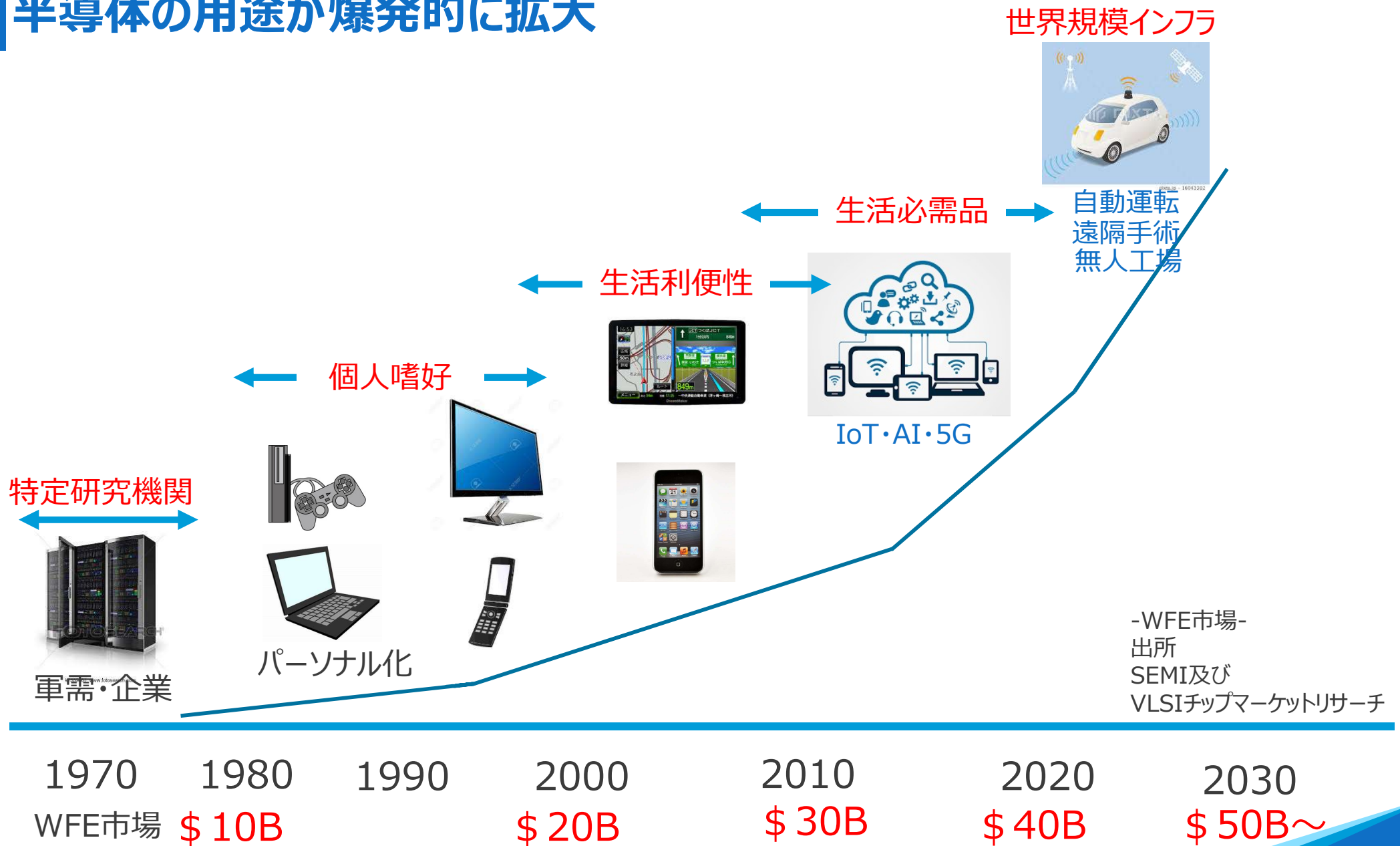
内外テック
技術提案商社



内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

= モノづくりができるメーカー商社

半導体の用途が爆発的に拡大



・売上高は期初予想を下回り、減益幅拡大

⇒メモリの需給バランス調整から受注が期初計画に対し下方に推移

・中長期的なIoT市場の拡大を見据えた増産体制を整備

⇒ 内外エレクトロニクス

仙台市 第3工場 竣工 (2018年10月竣工・稼働)

奥州市 工場用地 取得 (2018年5月取得)

・受託製造事業における業務提携契約の締結

⇒ 入江工研・内外テック・内外エレクトロニクス (2018年9月締結)

・業務の効率を確保する基幹システムを構築

⇒ 内外テックは9月稼働

内外エレクトロニクスは来期稼働予定

入江工研株式会社 ご紹介

代表取締役社長 入江則裕

設立 昭和41年5月24日

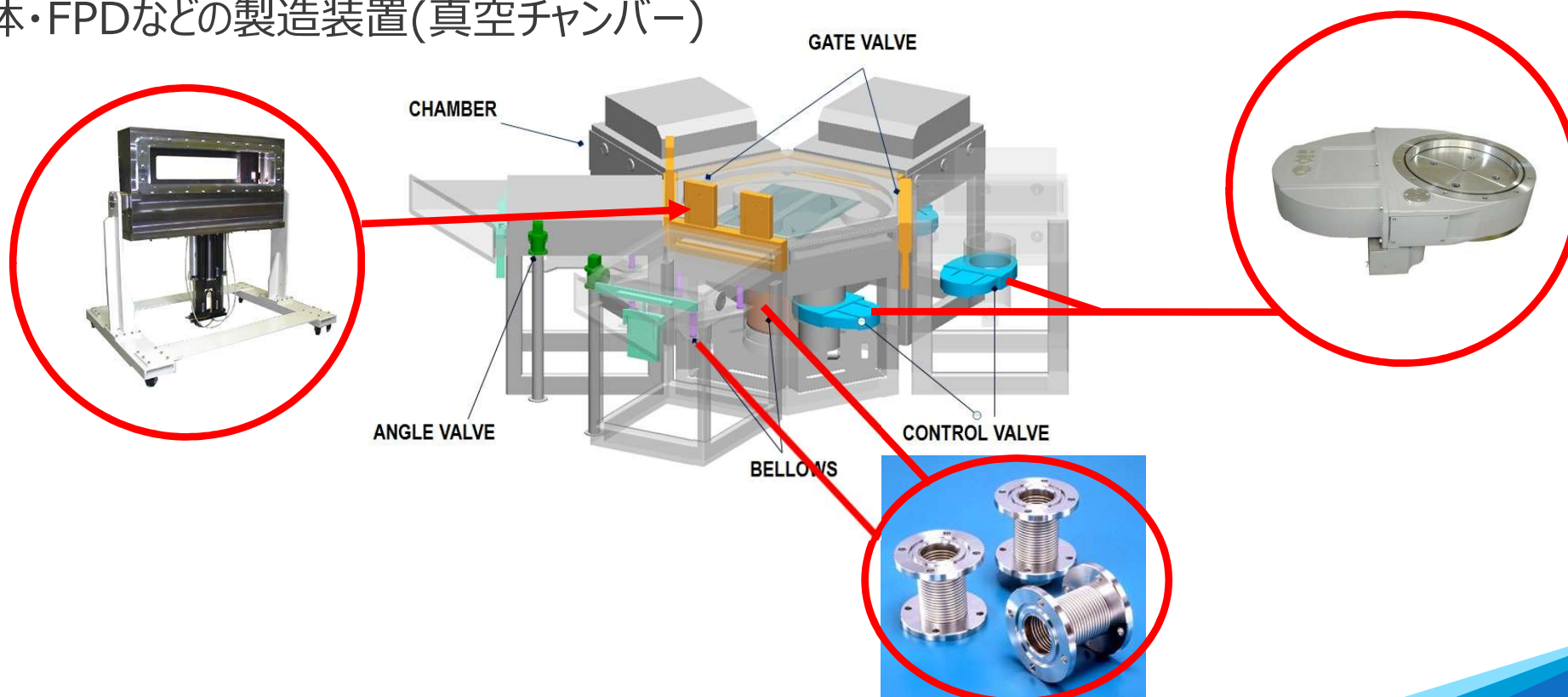
所在地

本社 東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル8階

工場 内子工場・中山工場(愛媛県)、テクニカルセンター(埼玉県)

主製品と強み 真空環境で使用するベローズや大型ゲートバルブの老舗メーカーです。特に大型ゲートバルブは世界三大メーカーの一角として真空業界のリーダ的役割を果たしております。

半導体・FPDなどの製造装置(真空チャンバー)



期初予想を下回り、減益幅拡大

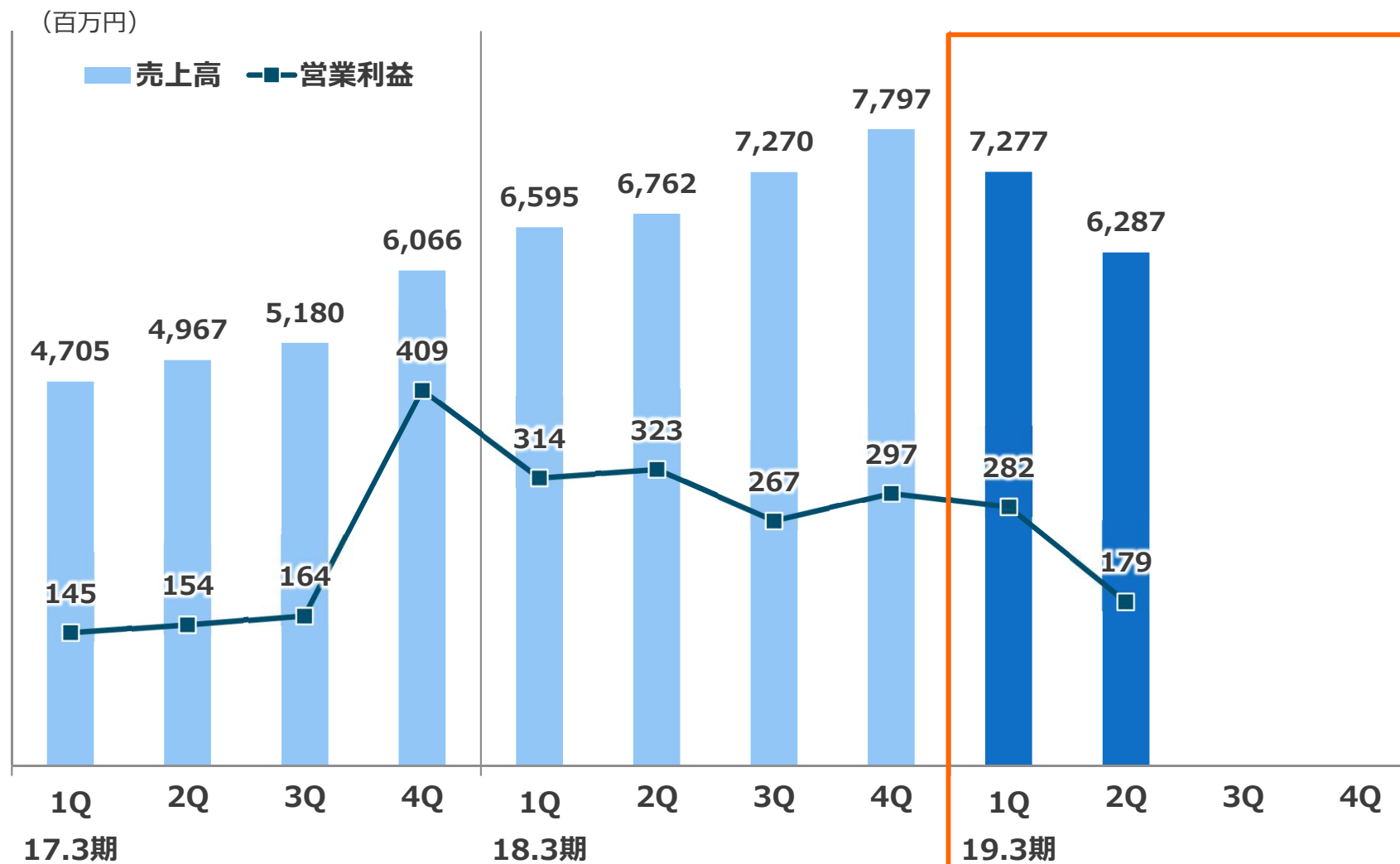
(百万円、%)

	2018.3期 2Q			2019.3期 2Q			期初予想
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	
売上高	13,358	38.1	100.0	13,565	1.5	100.0	15,681
売上原価	11,759	37.2	88.0	11,985	1.9	88.4	-
販管費	961	19.6	7.2	1,117	16.2	8.2	-
営業利益	637	112.4	4.8	462	△27.5	3.4	531
経常利益	624	114.8	4.7	457	△26.7	3.4	530
親会社株主に帰属する 当期純利益	415	80.1	3.1	290	△30.0	2.2	349

- 売上高は、DRAMを中心としたメモリの需給バランス調整から、一部の半導体メーカーで設備投資に慎重な動きが加わる等、期初予想を下回る。
- 販管費は、中長期的なIoT市場の拡大に備えた先行投資（営業・管理・製造体制強化）を推進したことから、前年同期比大幅増加。
- 各段階利益は、販管費増加から前年同期比減益。

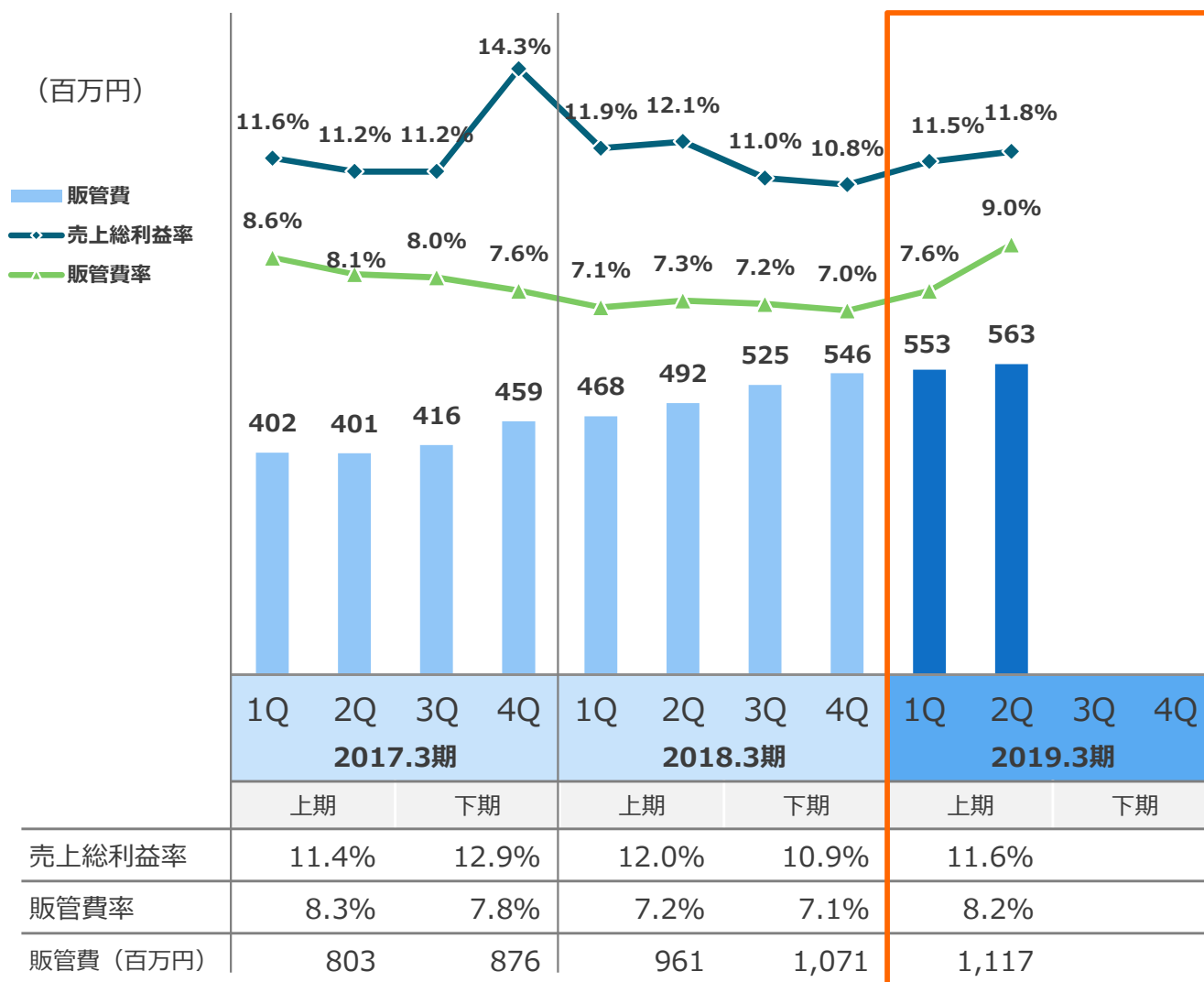
売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

売上高はメモリの需給バランス調整等から2Q大幅減少



売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は着実に上昇 先行投資により販管費は増加



売上総利益率

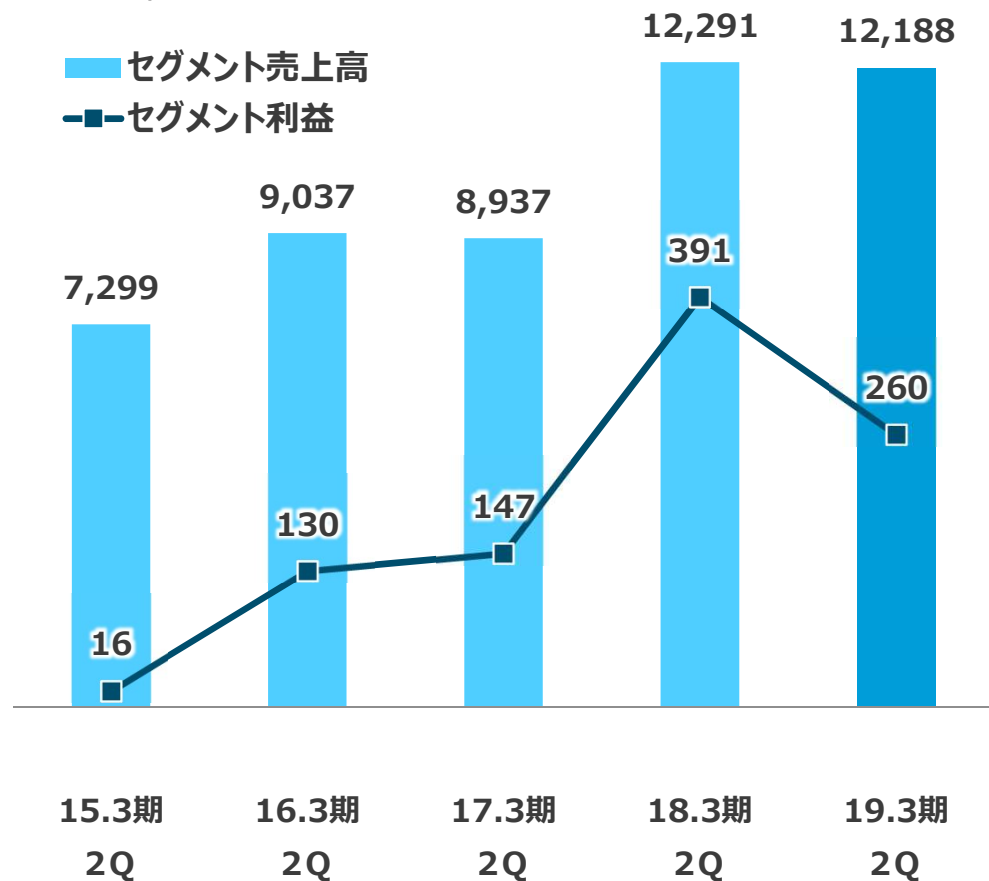
- 着実に上昇。

販管費

- 中長期的な I o T 市場の拡大による半導体需要を見据えた積極投資により販管費増加。
- 人員強化は上期に一定の範囲で終了。
- 売上高減少・販管費増加により販管費率は上昇。

売上高は、販売先の一時的な生産調整から微減 利益は、先行投資により大幅減少

(百万円)



セグメント売上高 前年同期比 0.8%減

- 販売先の一時的な生産調整から減少。
- 技術営業員のほか、一般営業員を増員し営業力を強化。
- サプライチェーン（販売先・仕入先）を強化。
- 商品戦略に基づく差別化商材の拡販。

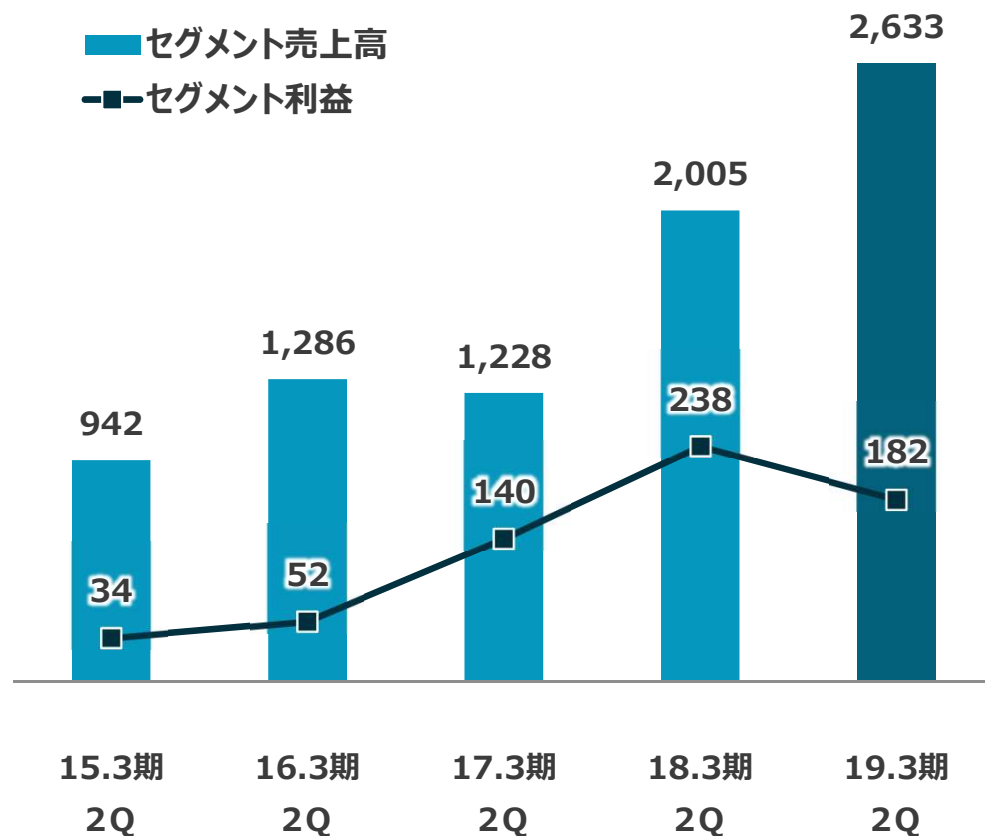
セグメント利益 前年同期比 33.5%減

- 売上減少に伴う売上総利益の減少。
- 先行投資に係る販管費の増加によりセグメント利益は大幅減少。

(注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

期初計画は下回るものの売上高は着実に拡大 利益は販売先の一時的な生産調整から大幅減少

(百万円)



セグメント売上高 前年同期比 31.4%増

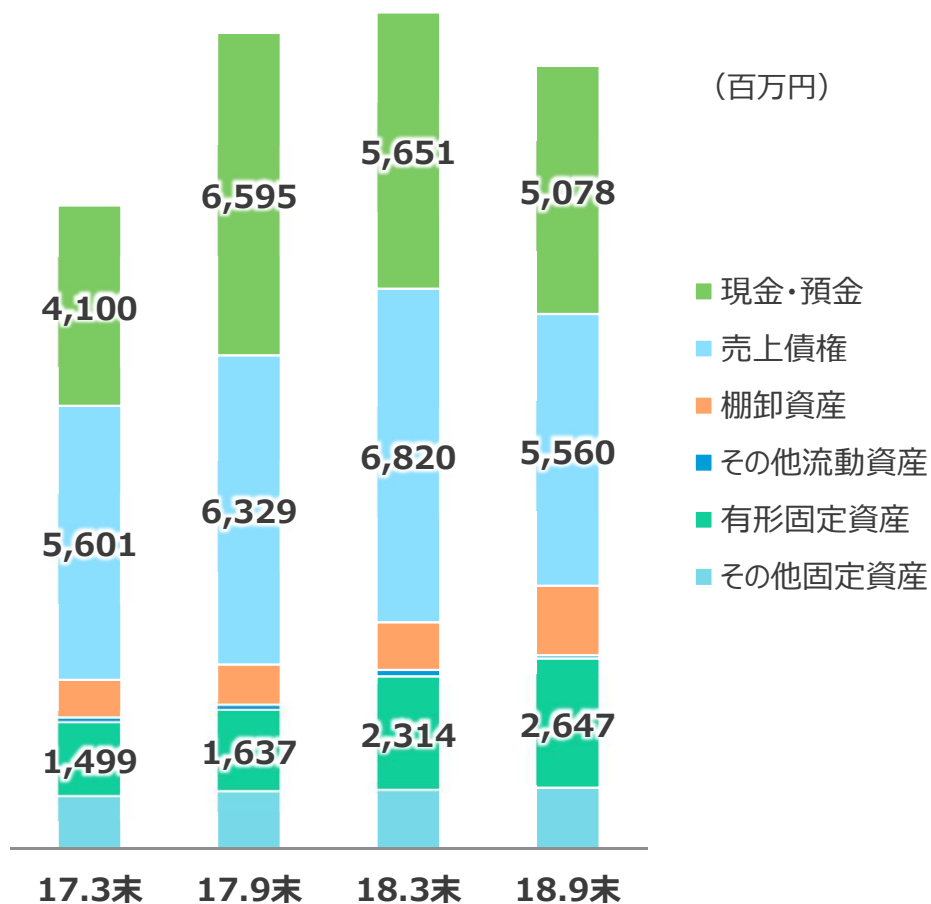
- 引き続き、受託製造事業を拡大。
- 仙台事業所第3工場の竣工・稼働、福島事業所の生産スペースの拡大等により主要顧客の生産増に対応。
- 製造・開発に係る業務提携契約の締結により受注拡大・開発体制を強化。

セグメント利益 前年同期比 23.4%減

- 増産体制構築の中、販売先の一時的な生産調整によりセグメント利益は前年同期比減少。

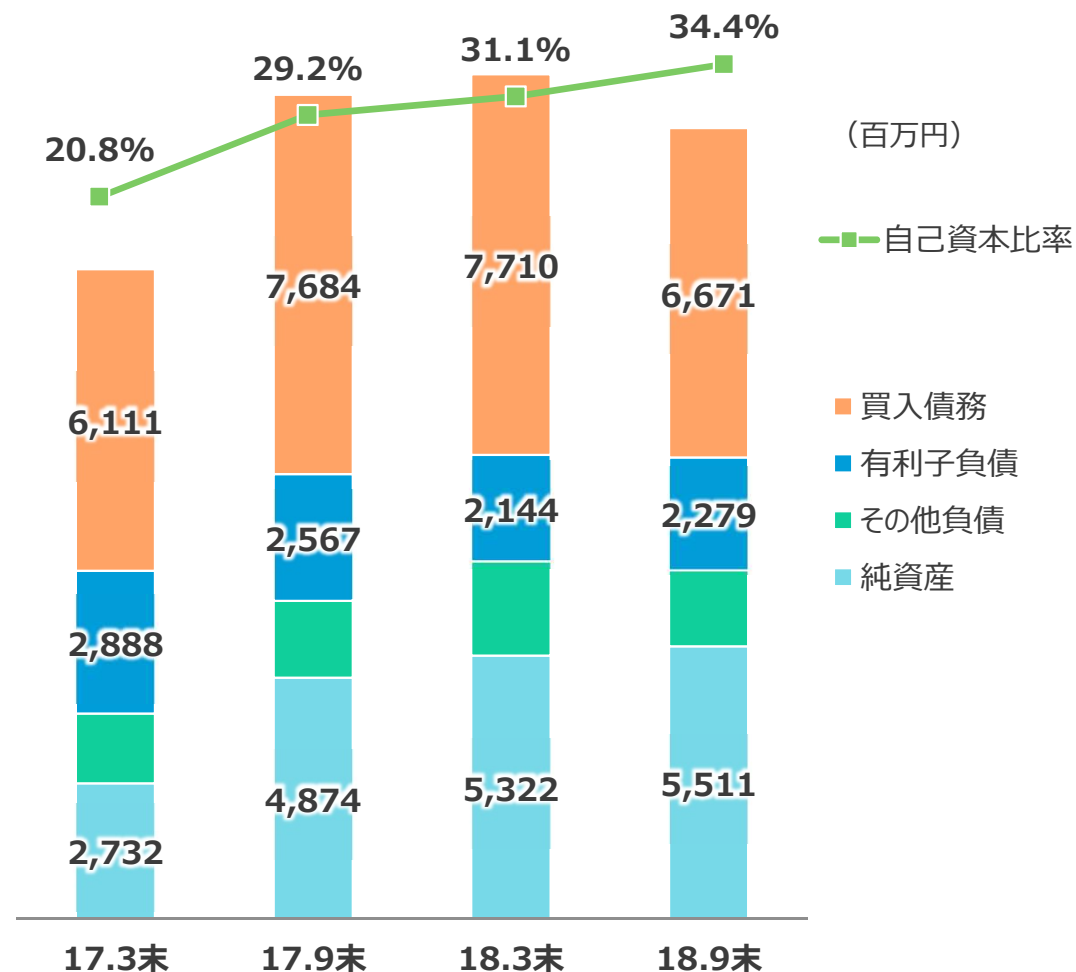
(注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

◆ 資産



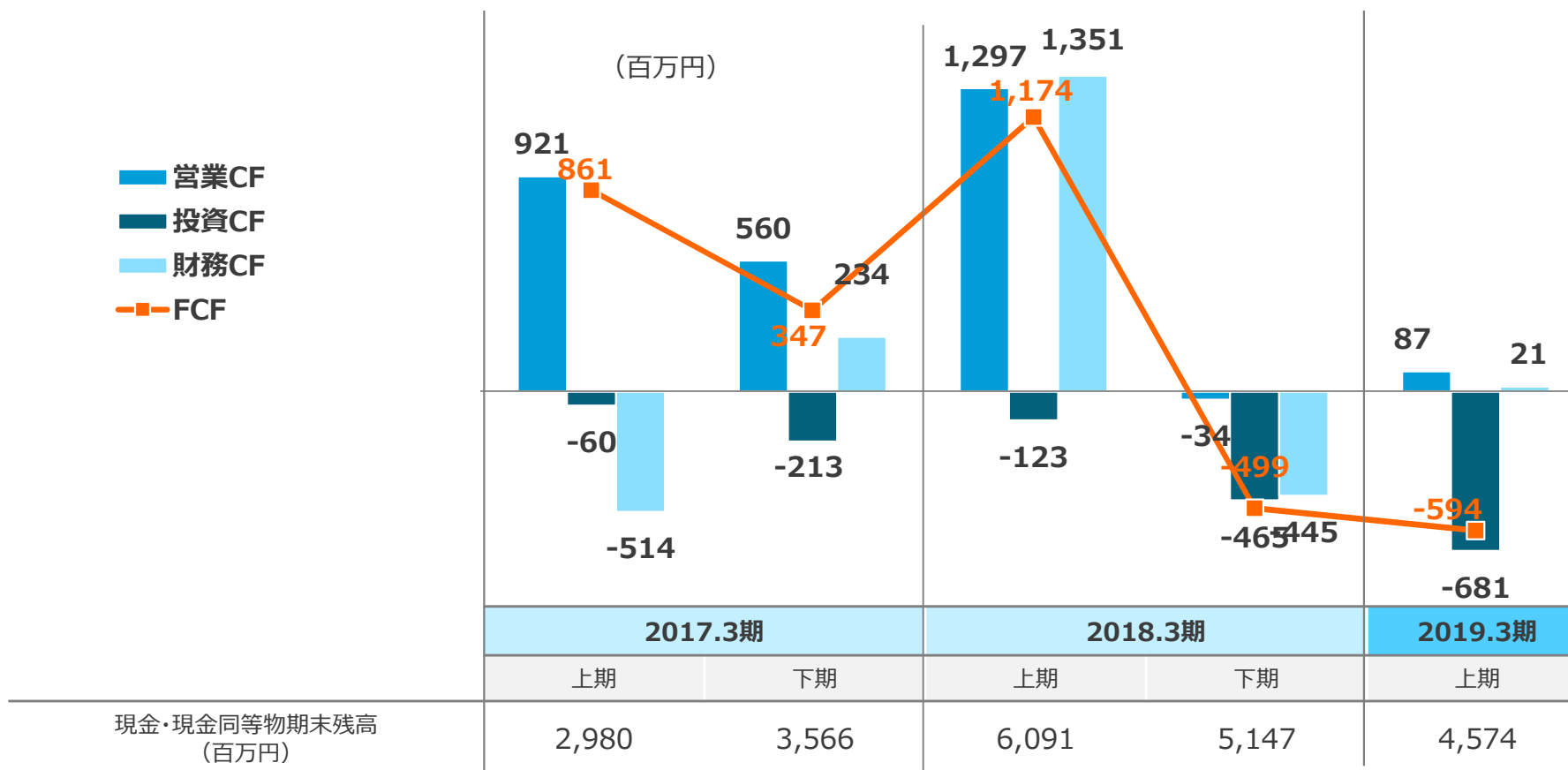
- 現金・預金は5億73百万円減少。
(受託製造事業の拡大に向けた投資強化)
- 内外エレクトロニクスの仙台事業所第3工場設備投資等により有形固定資産は18.3末比3億33百万円増加。

◆ 負債・純資産



- 利益の積み上げにより、純資産は55億円、自己資本比率は34.4%に向上。
- 有利子負債は1億35百万円の増加。
- 財務体質を強化。

増産体制に向けた設備投資強化 (2018年3月期より推進強化)



- 将来に向けた設備投資の実施により投資キャッシュフローは△681百万円。
- 投資に伴う販管費の増加による当期純利益減少から営業キャッシュフローは87百万円に減少。

2019年3月期 予想

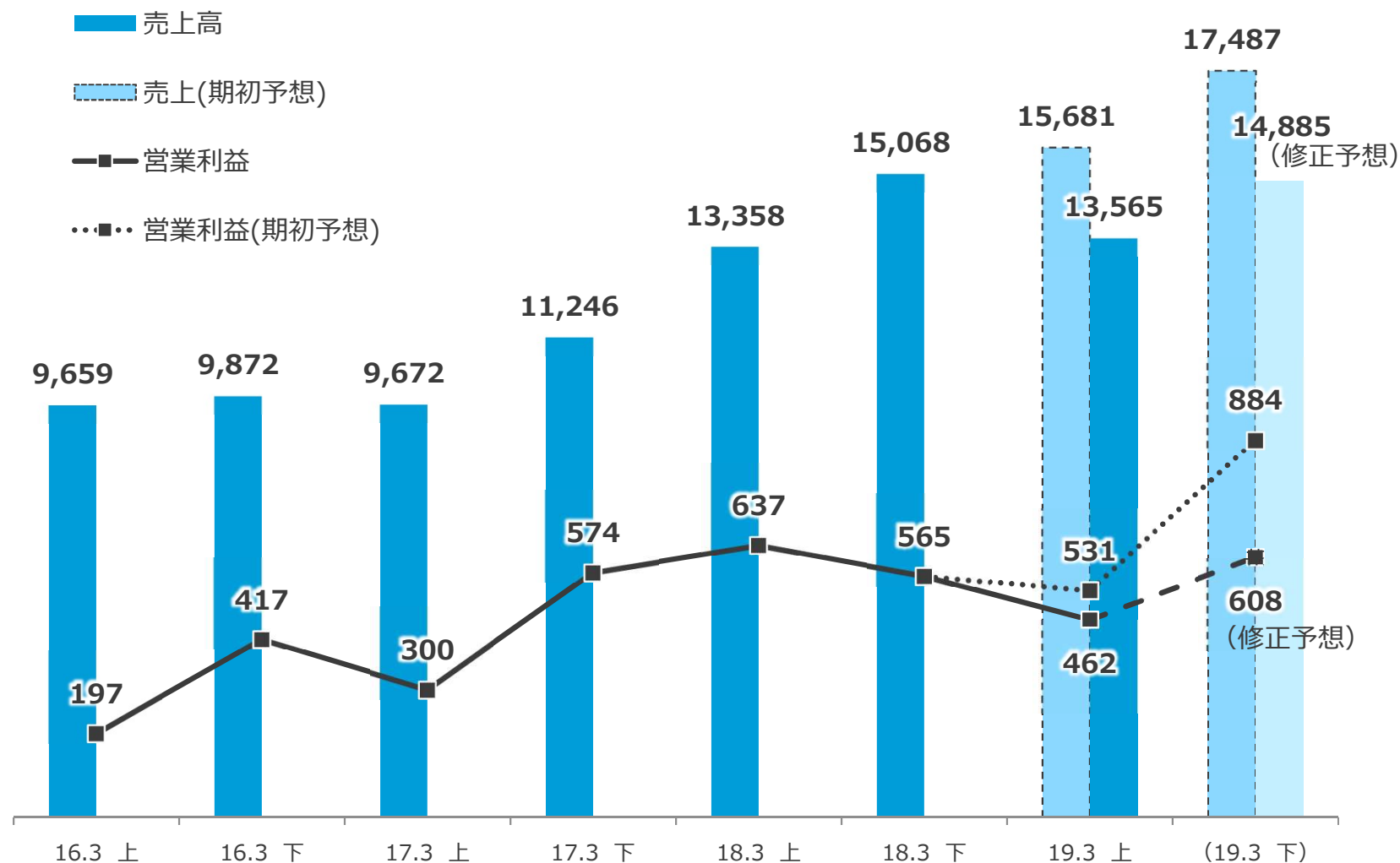
下期売上高回復見込むも、通期では期初予想を下回り減益予想に

(百万円、%)

	2018.3期			2019.3期				
	実績	前年同期比	構成比	修正予想	前年同期比	構成比	上期進捗率 (対修正予想)	期初予想
売上高	28,426	35.9	100.0	28,450	0.1	100.0	47.7	33,168
営業利益	1,202	37.6	4.2	1,070	△11.0	3.8	43.2	1,415
経常利益	1,184	39.5	4.2	1,065	△10.1	3.7	42.9	1,419
親会社株主に帰属する 当期純利益	857	36.8	3.0	700	△18.4	2.5	41.6	940

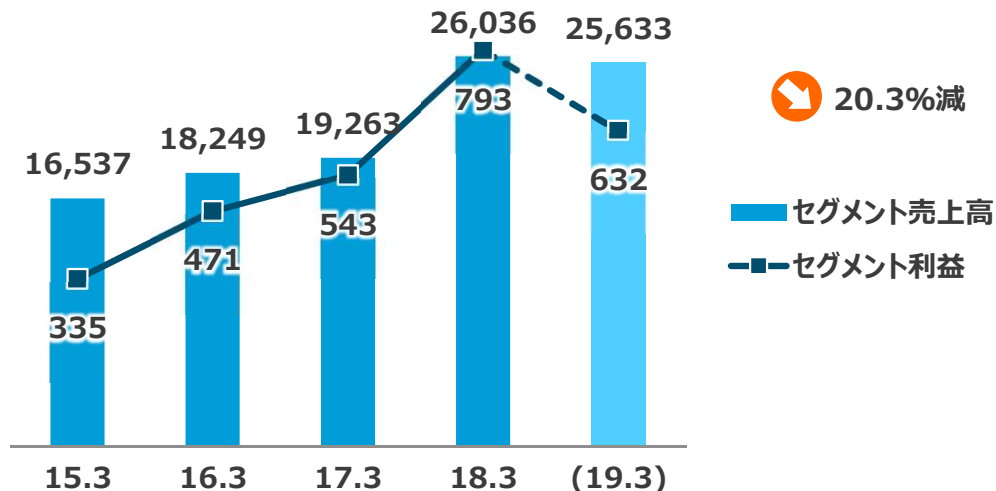
- 売上高は、下期受注回復により、通期で前期並みの予想。
- 各段階利益は、先行投資に伴う製造原価・販管比率増から前年同期比マイナスを予想。
- 下期利益は、受注回復に伴い改善予想。

期初計画を下回るも、下期は回復見込



◆ 販売事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 **1.5%減** ▶

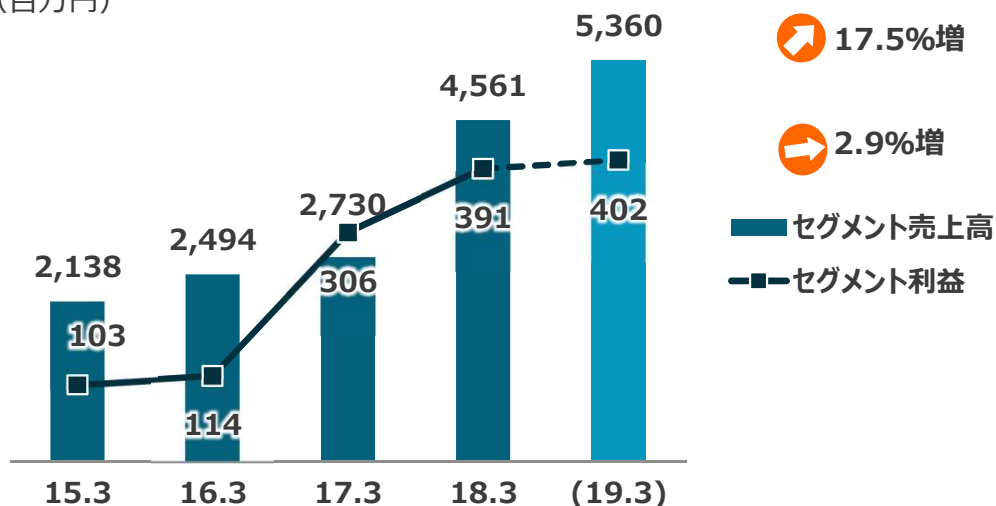
- 下期回復を見込むも上期の減少の影響を受け微減予想。

セグメント利益 前期比 **20.3%減** ▶

- 上期中盤より費用の優先度の見極めを行うも、営業・管理体制強化による販管費増加から、前期比大幅減益を予想。

◆ 受託製造事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 **17.5%増** ▶

- 一時的な受注減少の影響を受けるも通期では17.5%の増加予想。
- 仙台第3工場の竣工により増産に係る設備投資はおおむね完了。

セグメント利益 前期比 **2.9%増** ▶

- 下期受注回復から通期では4億2百万円の利益を予想。
- 新規受託・増産にともなう製造員の確保と教育の先行投資は引き続き発生。
- 仙台事業所第3工場の稼働に伴い減価償却費負担が増加。

(注) 連結単純合算よりセグメント内取引を消去した内容で表示しております。

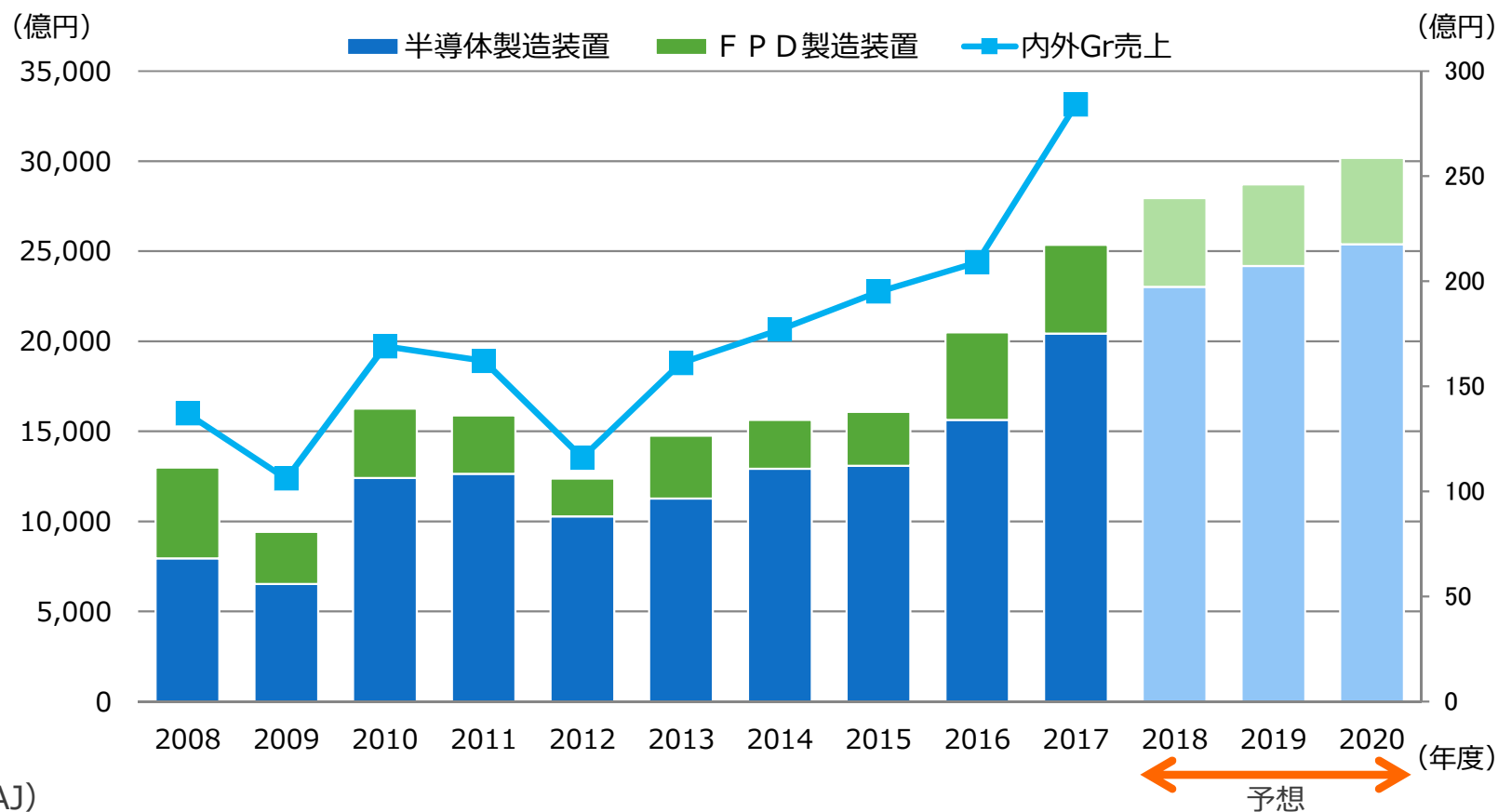
今後の成長に向けた設備投資の現状

代表取締役会長 権田 浩一

今後も見込まれる半導体製造装置市場の拡大（積極的な増産投資）

- 2018年7月5日に半導体製造装置市場予測 上方修正（SEAJ）

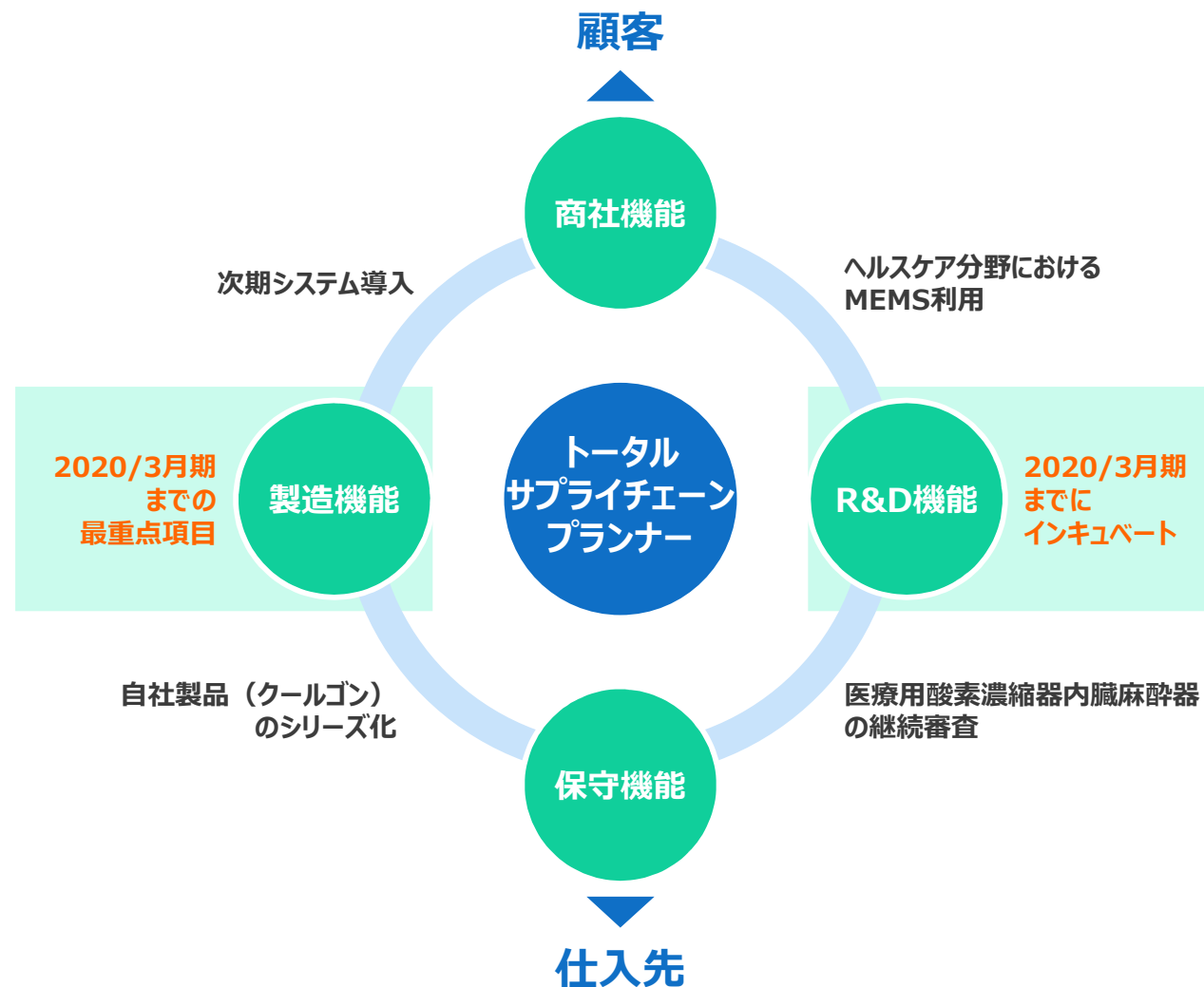
半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



トータル サプライチェーン プランナー企業

トータル サプライチェーン プランナー企業へ 4 機能強化

- I 商社機能の強化
⇒提案型商社/技術商社
- II 製造機能の強化
⇒請負から製造メーカーへ
(開発・調達・製造一気通貫)
- III メンテナンス機能の強化
⇒選択と集中
- IV R&D機能の強化
⇒新市場への挑戦
(自社・医療機器開発)



受託製造事業の生産能力は、
現在の売上53億円から70～75億円まで拡大

受託製造事業（子会社 内外エレクトロニクス）

仙台事業所

2018年10月 第3工場竣工

（エッチング装置関連）



土地面積 12,945㎡
クリーンルーム 2,771㎡



延床面積 7,434㎡

受託製造事業（子会社 内外エレクトロニクス）

福島事業所 増築棟
2019年1月 竣工予定
（大型パネル装置関連）



熊本事業所（仮称）
2019年1月 改修完了予定
（半導体装置関連）



本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社